

PRESSEMITTEILUNG

PRESSEMITTEILUNG28. Oktober 2025 || Seite 1 | 5

»German Chips Competence Centre« als deutsches Tor zur europäischen Pilotlinien- und Designinfrastruktur gestartet

Mit dem Start des »German Chips Competence Centre« (G3C) öffnet sich deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein direkter Zugang zu Europas modernster Halbleiterinfrastruktur. Als zentrale Schnittstelle verbindet das G3C das deutsche Halbleiterökosystem mit europäischen Design- und Fertigungspilotlinien, koordiniert deren Nutzung und vermittelt Kontakte in andere EU-Länder. So profitieren deutsche Akteure frühzeitig von neuen Entwicklungen – und Deutschland als Halbleiterstandort gewinnt eine Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus. Das G3C wird in den kommenden vier Jahren durch die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) aufgebaut und im Rahmen des EU Chips Act durch Mittel der Europäischen Union sowie eine nationale Kofinanzierung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert.

Am 28. Oktober 2025 wurde das »German Chips Competence Centre« (G3C) im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses in Duisburg feierlich eröffnet – mit Beiträgen von Dr. Stephan Guttowski (Leiter der FMD-Geschäftsstelle), Dr. Oliver Höing (Referent im BMFTR), Alexander Stanitzki (G3C-Projektleiter) und Dr. Björn Lekitsch (Co-Founder und CTO von neQxt).

Der europaweite Aufbau der Chips Competence Centres ist ein Kernbestandteil des EU Chips Act und ergänzt die entstehenden europäischen Pilotlinien. Gemeinsam bilden sie ein Rückgrat, das Forschung und Industrie enger miteinander verzahnt. Das G3C fungiert darin als deutscher Zugangspunkt – eingebettet in ein Netzwerk, das die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft Europas stärkt.

»Europa entscheidet jetzt über die Zukunft seiner Halbleiterindustrie. Mit dem G3C macht Deutschland seine Kompetenzen sichtbar und bringt deutsche Expertise ein, um den Wissens- und Technologietransfer auf europäischer Ebene zu fördern«, sagt Matthias Hauer, Parlamentarischer Staatssekretär im BMFTR.

PRESSEINFORMATION28. Oktober 2025 || Seite 2 | 5

Zugang für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups

Das G3C unterstützt Start-ups, KMU und etablierte Unternehmen aus Deutschland beim Zugang zur europäischen Design- und Pilotlinieninfrastruktur für Schlüsseltechnologien wie Advanced Packaging, photonische integrierte Schaltungen, FD-SOI und Wide-Band-Gap-Halbleiter. Ziel ist es, Innovationshürden zu senken und den Markteintritt genau für die Unternehmen zu beschleunigen, die bislang nur schwer Zugang zu komplexen Entwicklungs- und Testumgebungen hatten.

»Mit dem G3C schaffen wir für deutsche Innovationstreiber eine Brücke zur europäischen Chips-Infrastruktur – sowohl im Bereich Chipdesign als auch für die Fertigung. Gerade für KMU und Start-ups bedeutet das: einfachere Realisierung von Prototypen, schnellere Skalierung vom Labor zum Serienmuster, früherer Markteintritt – und damit mehr Chancen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Außerdem entwickelt das G3C künftig praxisnahe Trainings- und Schulungen, die beim Aufbau dringend benötigter Fachkompetenzen unterstützen«, erklärt Alexander Stantzki, Projektleiter des G3C.

Als nationale Anlaufstelle bündelt das G3C Informationen zu allen europäischen Design- und Fertigungsangeboten, berät zu deren Nutzung und koordiniert Einweisungen und Weiterbildungsangebote. Damit übernimmt es – wie die anderen europäischen Chips Competence Centres – eine koordinierende Rolle und macht relevante Infrastruktur- und Serviceangebote über nationale Grenzen hinweg zugänglich.

»Für Start-ups wie unseres kann das G3C einen enormen Mehrwert darstellen«, sagt Dr. Björn Lekitsch, Mitgründer und CTO von neQxt. »Wir erhoffen uns vom Chips Competence Centre einen direkten Zugang zu

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Ressourcen und eine erleichterte bessere Vernetzung mit wichtigen Technologiepartnern, was uns helfen würde, Entwicklungsprojekte deutlich zu beschleunigen. Für neQxt erhöht das die Chance, mit unseren zukünftigen Angeboten wettbewerbsfähig zu werden, da wir früher auf den Markt kommen können.«

PRESSEINFORMATION28. Oktober 2025 || Seite 3 | 5

Sichtbarkeit und Koordination im europäischen Netzwerk

Das G3C wurde im Rahmen des EU Chips Act initiiert, der Europas technologische Resilienz stärken und den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Halbleiterindustrie fördern soll. Neben der technologischen Unterstützung übernimmt das G3C eine strategische Vermittlungsfunktion: Es repräsentiert das deutsche Halbleiterökosystem auf europäischer Ebene, sorgt für internationale Sichtbarkeit und bringt deutsche Kompetenzen gezielt in das European Network of Chips Competence Centres (ENCCC) ein.

»Auch die enge Verzahnung mit bestehenden Strukturen wie der APECS-Pilotlinie ist Teil des Auftrags«, erklärt Dr. Stephan Guttowski, Leiter der FMD-Geschäftsstelle, und ergänzt: »Darüber hinaus knüpft das G3C an die weiteren Pilotlinien – FAMES, NanoIC, PIXEurope und WBG – an, um Synergien entlang der gesamten mikroelektronischen Wertschöpfungskette zu schaffen.«

Mit dem G3C entsteht so ein funktionierendes Gesamtsystem, in dem die Industrie auf alles zugreifen kann, was sie für Innovationen benötigt.

Stärkung des deutschen Halbleiterstandorts

Mit dem G3C erhält Deutschland einen zentralen Zugang zu Europas modernster Halbleiterinfrastruktur. Es bündelt Wissen, vermittelt Partnerschaften und eröffnet neue Wege für Forschung und Innovation. Damit stärkt das G3C die Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und internationale Sichtbarkeit des deutschen Halbleiterstandorts nachhaltig.

Die Gesamtfinanzierung des G3C beläuft sich auf 7,9 Millionen Euro über eine Projektlaufzeit von vier Jahren.

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de



PRESSEINFORMATION

28. Oktober 2025 || Seite 4 | 5

Feierliche Eröffnung des G3C zum diesjährigen MST-Kongress in Duisburg. V.l.n.r.: Dr. Björn Leckitsch (Co-Founder und CTO von neQxt), Alexander Stanitzki (G3C-Projektleiter), Dr. Stephan Gutowski (Leiter der FMD-Geschäftsstelle) und Dr. Oliver Höing (Referent im BMFTR).

© Fraunhofer Mikroelektronik



Das G3C bietet deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen Zugang zur europäischen Design- und Pilotlinieninfrastruktur.

© Fraunhofer Mikroelektronik

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Über die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD)

Die FMD als Kooperation von 13 Fraunhofer-Instituten mit den Leibniz-Instituten FBH und IHP ist der zentrale Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um die mikro- und nanoelektronische Forschung und Entwicklung in Deutschland und Europa. Als One-Stop-Shop verbindet die FMD wissenschaftlich exzellente Technologien und Systemlösungen ihrer kooperierenden Forschungsinstitute zu einem kundenspezifischen Gesamtangebot. Unter dem virtuellen Dach der FMD entstand somit 2017 einer der größten Zusammenschlüsse dieser Art mit inzwischen mehr als 5400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer einzigartigen Kompetenz- und Infrastrukturvielfalt. Mehr Informationen finden Sie unter www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

PRESSEINFORMATION

28. Oktober 2025 || Seite 5 | 5

Über die APECS-Pilotlinie

Im Rahmen des EU Chips Acts wird die FMD mit APECS in den kommenden Jahren eine umfassende Pilotlinie für resiliente und vertrauenswürdige heterogene Systeme aufbauen, die die Innovationsfähigkeit der europäischen Industrie in ihrer gesamten Breite fördert. Durch die Aktivierung neuer Funktionalitäten im Rahmen der »System Technology Co-Optimization« (STCO), ein end-to-end Design sowie Pilotproduktionskapazitäten ermöglicht die Pilotlinie die Weiterentwicklung von Innovationen von der Forschung zu praktischen, skalierbaren Fertigungslösungen. Darüber hinaus bietet APECS einen One-Stop-Shop für Kunden in praktisch allen klassischen vertikalen Industriebranchen, einschließlich Großunternehmen, KMU und Start-ups. APECS bringt die Kompetenzen, Infrastrukturen und das Know-how von zehn Partnern aus acht europäischen Ländern zusammen. In Deutschland sind zwölf Institute der Fraunhofer-Gesellschaft (Projektkoordinator) und zwei Institute der Leibniz-Gemeinschaft an der Pilotlinie beteiligt. Umgesetzt wird APECS von der FMD. Mehr Informationen finden Sie unter <https://www.apecs.eu/>

Pressekontakt Romy Zschiedrich, Leiterin Kommunikation

E-Mail: romy.zschiedrich@mikroelektronik.fraunhofer.de | Mobil: +49 173 5434 126

www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de
